

## HORNO DE REBALLING ZHUOMAO ZM-R255



ZM-R255

Especificaciones.

- 1.....Dimensión de plancha de calentamiento : 120mm\*200mm
- 2..... Dimensión de plancha de enfriamiento : 120mm\*200mm
- 3.....Consumo eléctrico : 600W
- 4.....Configuración temperatura: Temp 20 a 300°C, PID (termocoupla).

4.....Tiempo de Alarma : 0.1 a 10 minutos.

5.....Voltaje : AC220V.

6.....Dimensiones : 310mm\*280mm\*145mm (L\*W\*H)

7.....Peso: 7.7 KG

#### Características.

1. Cubre los requerimientos deISO-9000 del FLUX de soldado.
2. Con material de calentamiento de alta calidad, display digital para seteo de temperatura y seteo de tiempo muy preciso, controlador estable de temperatura.
3. Múltiples sistemas de seguridad que aseguran la operación.
4. Placa aleación de aluminio, que se calienta desde la base, estable, eliminando el daño al chip BGA.
5. Capaz de soldar BOLITAS a varios chip BGA de diferentes especificaciones al mismo tiempo.
6. Placa de enfriamiento para evitar el stress térmico del chip.
7. Tapa de protección con cerramiento que evita la apertura accidental luego del trabajo, evitando quemaduras.

#### Pasos de operación.

1. Encender el equipo, configure los parámetros en el controlador de temperatura(C10), (con plomo, 220 °-240 °/libre de plomo, 245 °-265 °).
2. Usar un soldador y con ayuda de malla desoldante quite el estaño del BGA y PCB.
3. Use alcohol isopropilico para limpiar residuos del flux.
4. Sobre la superficie del pad BGA, PCB, cubra con una pequeña cantidad de flux especial para BGA, (recomendamos Amtech original ya que no deja residuos) , asegurando y ayudando al efecto del soldado.
5. Escoja las bolitas de reballing correspondientes con el chip BGA, colóquelas con ayuda del stencil correspondiente, tenga cuidado que coincidan con el lugar a soldar

6. Cuando la máquina muestre la temperatura de la placa y la temperatura seteada y estas coincidan, coloque el chip sobre el film especial provisto con la máquina, no coloque el chip directamente sobre la platina.

7. Cuando el proceso haya terminado deslice el film con el chip arriba con cuidado a la platina de la derecha para el proceso de enfriado.

8. Después que las bolitas de reballing hayan enfriado, si quedan residuos en la superficie, limpie flux sobrante.

9. Retire BGA chip que termino el proceso de reballing y apague el equipo.

La platina derecha se atempera en el proceso de reballing para recibir al chip y no producirle stress térmico que pueda dañarlo, déjelo que tome una temperatura en la que pueda manipularlo.

10. Luego baje la tapa y cierre con los seguros laterales colocados, esto evitara quemaduras accidentales.

Tenga mucho cuidado en el proceso, de no tocar la placa de la izquierda ya que puede sufrir graves quemaduras.